



京都産学公連携機構

第8回未来技術交流会

ものづくりの小型化・細密化・高精度化を支える新しい加工技術

主催：京都商工会議所・京都産学公連携機構

大学と中堅・中小企業が、成長や将来的な需要が期待できる産業分野の未来技術や未来社会を考え、新たな製品開発を目指す未来産業のタネを考える場「未来技術交流会」を、「生産技術」をテーマに開催致します。産学連携のきっかけ作りには是非ご参加ください。

【日 時】平成26年12月15日（月）15：00～18：00

【場 所】京都商工会議所 役員室（3階）

京都市中京区烏丸通夷川上ル
地下鉄「丸太町駅」6番出口すぐ！

【第一部】基調講演・意見交換 15：00～17：00

1. 『次世代半導体材料の紫外光支援加工』

（シリコンに代わる半導体材料として注目されている炭化ケイ素（SiC）や窒化ガリウム（GaN）などは非常に硬く、熱的・化学的にも極めて安定であるため、加工が困難な材料としても有名である。紫外光支援加工は、これらの材料に紫外光を照射することで比較的軟質な酸化膜を形成し、高品位な加工面を得る手法として期待される。）

講師：京都工芸繊維大学 機械システム工学部門 助教 山口 桂司 氏

2. 『機械加工による超微細加工事例』

（近年の工業製品の小型化および部品の高密度化により、多くの生産現場で微細加工の需要が高まっている。本講演では、講演者の研究グループが今までに試みてきた放電加工や切削加工、研削加工、超音波加工などの各種機械加工による超微細加工の加工事例を紹介する。）

講師：京都工芸繊維大学 機械システム工学部門 准教授 江頭 快 氏

【第二部】懇親・交流会 17：00～18：00

【対象】「生産技術」分野での産学連携等に関心のある中堅・中小企業の代表者、技術担当者等

【申込方法】下記の申込書にご記入の上、FAXまたはE-mail、HPからお申し込みください。

【参加費】無料（但し第二部懇親・交流会参加の場合は別途1,000円を当日拝受いたします。）

【定員】30名（先着順）

【お申込み・お問合せ先】京都商工会議所 産業振興部 鈴木、和久、立川

TEL:075-212-6443 FAX:075-255-0428 E-mail:shinkou@kyo.or.jp URL:<http://sangakukou.kyoto.jp/>

FAX:075-255-0428

京都商工会議所 産業振興部 宛

「第8回 未来技術交流会」(12/15) 参加申込書

ご所属の企業・機関名

ご役職

貴名

電話:

第二部懇親・交流会の参加の有無（有・無）

※ご記入頂いた情報は、主催者からの各種連絡・情報提供のために利用するのをはじめ、講師に参加者名簿として配布致します。

※駐輪場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。